



## X-FAB 在制造工艺上的突破为电隔离解决方案增加 CMOS 集成选项

中国北京, 2023 年 11 月 3 日——全球公认的卓越的模拟/混合信号晶圆代工工厂 [X-FAB Silicon Foundries](#) (“X-FAB”) 今日宣布, 在电隔离技术领域取得重大进展——X-FAB 在 2018 年基于其先进工艺 XA035 推出针对稳健的分立电容或电感耦合器优化之后, 现又在此平台上实现了将电隔离元件与有源电路的直接集成。这是 X-FAB 对半导体制造工艺上的又一重大突破。这一集成方法使隔离产品的设计更加灵活, 从而应对可再生能源、EV 动力系统、工厂自动化和工业电源领域的新兴机遇。

XA035 基于 350 纳米工艺节点, 非常适合制造车用传感器和高压工业设备; XA035 目前支持的高压信号隔离能力意味着即使在苛刻的环境中也能保持持续稳定的运行性能。该技术可以制造符合 AEC-Q100 0 级标准和工业等级的坚固元件, 如数字隔离器、隔离栅极驱动器和隔离放大器 IC。X-FAB 提供全面的 PDK, 支持所有主要 EDA 供应商全新及改进的工艺技术。

“我们看到电隔离产品设计领域客户对强大代工解决方案的需求日益增长, X-FAB 在分立耦合器实施方面的高可靠性隔离层也已投产数年。” X-FAB 高压产品市场经理 Tilman Metzger 表示, “通过利用相同的工艺模块, 我们现能够在同一裸片上直接集成 CMOS 电路, 从而为此类产品的设计打造更大灵活性。我们也十分高兴看到客户的首批集成型产品即将投产。”

### 缩略语:

CMOS	互补金属氧化物半导体
EDA	电子设计自动化
EV	电动汽车
IC	集成电路
PDK	工艺设计套件

###

### 关于 X-FAB:

X-FAB 是领先的模拟/混合信号和 MEMS 晶圆代工集团, 生产用于汽车、工业、消费、医疗和其它应用的硅晶圆。X-FAB 采用尺寸范围从 1.0 $\mu$ m 至 110nm 的模块化 CMOS 和 SOI 工艺, 及其特色 SiC 与微机电系统 (MEMS) 长寿命工艺, 为全球客户打



造最高的质量标准、卓越的制造工艺和创新的解决方案。X-FAB 的模拟数字集成电路（混合信号 IC）、传感器 MEMS 在德国、法国、马来西亚和美国的六家生产基地生产，并在全球拥有约 4,200 名员工。[www.xfab.com](http://www.xfab.com)

欢迎扫码关注 X-FAB 官方微信公众账号，了解更多精彩资讯：



媒体联系：

王伟

X-FAB 中国区市场经理

86-21-2050 1645

[Angela.Wang@xfab.com](mailto:Angela.Wang@xfab.com)

乔治

GeoMatrix Public Relations Ltd.

86-10-8595 9439

[george.qiao@geomatrixpr.com](mailto:george.qiao@geomatrixpr.com)